

2023年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年5月15日

上 場 会 社 名 AIメカテック株式会社 上場取引所 東

コード番号 6227 URL https://www.ai-mech.com/

代表者(役職名)代表取締役執行役員社長(氏名)阿部猪佐雄

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名)米田 達也 (TEL) 0297-62-9111

四半期報告書提出予定日 2023年5月15日 配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年6月期第3四半期の連結業績(2022年7月1日~2023年3月31日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利	益	経常利	益	親会社株主 する四半期	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年6月期第3四半期	7, 771	14. 6	△489	_	△578	_	589	_
2022年6月期第3四半期	6, 781	△39. 7	△115	_	△156	_	△119	_

(注)包括利益 2023年6月期第3四半期 560百万円(-%)2022年6月期第3四半期 Δ73百万円(-%)

	1 株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年6月期第3四半期	104. 73	103. 95
2022年6月期第3四半期	△21. 26	_

⁽注)2022年6月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

(2) 連結財政状態

(二) (三) (三)				
	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年6月期第3四半期	23, 699	8, 353	35. 2	1, 483. 35
2022年6月期	18, 836	8, 046	42. 7	1, 428. 85

(参考) 自己資本 2023年6月期第3四半期 8,351百万円 2022年6月期 8,044百万円

2. 配当の状況

- : HD - 37 ////						
		年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円銭	円 銭	円銭	円銭	円銭	
2022年6月期	_	0.00	_	45. 00	45. 00	
2023年6月期	_	0.00	_			
2023年6月期(予想)				45. 00	45. 00	

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年6月期の連結業績予想(2022年7月1日~2023年6月30日)

(%表示は、対前期増減率)

(/0込が18代 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73							<u> </u>		
	売上高	5	営業利:	益	経常利	益	親会社株主 する当期料	に帰属 徳利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	16, 405	11. 7	705	△4.1	598	△11.9	1, 541	222. 2	273. 71

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
①以外の会計方針の変更
法無
会計上の見積りの変更
無
修正再表示

(4)発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

2023年6月期3Q	5, 630, 000株	2022年6月期	5, 630, 000株
2023年6月期3Q	20株	2022年6月期	20株
2023年6月期3Q	5, 629, 980株	2022年6月期3Q	5, 629, 989株

- ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
- ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 - ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の 業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に 当たっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想 などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(セグメント情報等)	9
(企業結合等関係)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、各国のゼロコロナ政策転換による需要増により緩やかな回復が続いたものの、インフレ率の高止まりと各国中央銀行の金融引き締め継続が欧米での金融不安を招き、景気後退懸念が高まりました。国内経済は、世界経済動向を受け外需が伸び悩む中、内需中心に緩やかな回復基調をたどりました。

当社グループの事業環境について、半導体業界において、景気後退懸念によりデータセンター投資の伸びに陰りが見える中、対応する先端半導体パッケージ向け投資も鈍化し、フラットパネルディスプレイ(FPD)業界では、世界的なIT製品需要減により市況回復が遅れ、いずれの業界でも顧客の投資計画見直しが顕在化しました。

このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の当社グループの受注金額は7,928百万円(前年同期比47.6%減)、受注残高は20,792百万円(前年同期比3.7%増)となりました。

当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高7,771百万円(前年同期比14.6%増)、営業損失489百万円(前年同期は営業損失115百万円)、経常損失578百万円(前年同期は経常損失156百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益589百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失119百万円)となりました。

セグメント別の概況は、以下のとおりです。

(IIPソリューション事業)

AR/VRに活用されるマイクロディスプレイ向け装置の売上が順調に立ち上っている一方、市況動向やデバイスの開発状況等を見極めたい顧客の投資計画見直しにより、受注・出荷の翌四半期以降へのずれ込みが目立ちました。引続き有機ELパネル中型化や次世代ディスプレイ向け投資ニーズの捕捉に注力し、受注の積み上げ、売上の拡大を図って参ります。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は2,536百万円(前年同期比107.1%増)、セグメント利益は35百万円(前年同期比27.4%減)となりました。

(半導体関連事業)

当社の主力である先端半導体パッケージ向け装置の売上は堅調に推移する一方、IT製品需要低迷によりメモリーを中心に在庫調整が続き、景気後退懸念によりデータセンター投資も力強さを欠く中、対応する設備投資にも鈍化が見られ、顧客の投資先送りによる受注の伸び悩みが顕在化しました。足許、中長期的な需要拡大が見込まれるパワー半導体向け装置等への引き合いは活発であり、今後の受注捕捉に注力して参ります。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は3,050百万円(前年同期比85.4%増)、セグメント利益は416百万円(前年同期比43.9%増)となりました。

(LCD事業)

I T製品需要減少によるパネル市況の低迷を受けた顧客の投資抑制により、新規ラインに加えアフターサービス (AS) 案件についても、受注・出荷が振るいませんでした。今後は、パネル市況の動向を見極めながらAS 案件の捕捉に注力し、一定規模の売上確保を目指して参ります。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は2,185百万円(前年同期比44.1%減)、セグメント損失は121百万円(前年同期は347百万円の利益)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ4,983百万円増加し、21,301百万円となりました。主として、棚卸資産5,378百万円の増加によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から68百万円増加し、2,361百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から8百万円増加し、30百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から197百万円減少し、6百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から4,863百万円増加し、23,699百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3,869百万円増加し、14,107百万円となりました。主として、短期借入金2,250百万円、前受金1,000百万円の増加によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ687百万円増加し、1,238百万円となりました。主として、長期借入金437百万円の増加によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ306百万円増加し、8,353百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益589百万円の増加によるものであります。

この結果、自己資本比率は35.2%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年6月期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、2022年8月9日に公表した業績予想を修正しております。詳細につきましては、2023年4月28日付「特別利益の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

本業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2022年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2, 430, 391	2, 057, 094
売掛金及び契約資産	9, 342, 550	8, 695, 340
電子記録債権	4, 974	20, 842
製品	10, 880	12, 412
半製品	98, 133	1, 888, 878
仕掛品	4, 066, 538	7, 651, 576
原材料	4, 634	5, 731
未収入金	269, 010	927, 841
その他	93, 417	43, 514
貸倒引当金	△2, 889	△1,618
流動資産合計	16, 317, 640	21, 301, 614
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	288, 729	314, 097
機械装置及び運搬具(純額)	1, 140, 987	1, 229, 712
工具、器具及び備品(純額)	43, 627	59, 640
土地	656, 000	656, 000
リース資産 (純額)	1, 320	_
建設仮勘定	162, 747	102, 157
有形固定資産合計	2, 293, 411	2, 361, 608
無形固定資産		
ソフトウエア	21, 327	30, 050
その他	0	0
無形固定資産合計	21, 327	30, 050
投資その他の資産		
繰延税金資産	193, 590	_
その他	10, 189	6, 322
投資その他の資産合計	203, 780	6, 322
固定資産合計	2, 518, 518	2, 397, 981
資産合計	18, 836, 159	23, 699, 595

(単	14		千	Ш)
THE P	11/	-	-	ш	,

	前連結会計年度 (2022年 6 月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	2, 645, 677	2, 693, 800
買掛金	2, 862, 039	3, 329, 715
短期借入金	3, 300, 000	5, 550, 000
リース債務	1, 475	_
未払金	111, 496	262, 621
未払費用	168, 211	219, 386
未払法人税等	181, 458	15, 698
前受金	632, 927	1, 633, 061
賞与引当金	205, 829	333, 070
役員賞与引当金	30, 600	25, 352
製品保証引当金	32, 000	29, 758
その他	66, 731	15, 222
流動負債合計	10, 238, 446	14, 107, 687
固定負債		
長期借入金	_	437, 500
役員退職慰労引当金	39, 878	46, 118
退職給付に係る負債	511, 490	485, 143
繰延税金負債	_	269, 946
固定負債合計	551, 368	1, 238, 708
負債合計	10, 789, 815	15, 346, 396
純資産の部		
株主資本		
資本金	450, 000	450,000
資本剰余金	4, 215, 238	4, 215, 238
利益剰余金	3, 254, 676	3, 590, 976
自己株式	△30	△30
株主資本合計	7, 919, 884	8, 256, 185
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	102, 431	76, 767
退職給付に係る調整累計額	22, 055	18, 273
その他の包括利益累計額合計	124, 486	95, 041
新株予約権	1,973	1, 973
純資産合計	8, 046, 344	8, 353, 199
負債純資産合計	18, 836, 159	23, 699, 595

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

		(単位:千円)
	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)
売上高	6, 781, 526	7, 771, 716
売上原価	5, 303, 711	6, 386, 273
売上総利益	1, 477, 815	1, 385, 442
販売費及び一般管理費	1, 593, 773	1, 875, 184
営業損失(△)	△115 , 958	△489, 742
営業外収益		
受取利息	4, 052	4, 299
為替差益	1, 217	_
その他	414	355
営業外収益合計	5, 684	4, 654
営業外費用		
支払利息	19, 187	21, 794
アレンジメントフィー	_	37, 500
コミットメントフィー	14, 016	9, 946
為替差損	_	18, 049
その他	12, 848	6, 142
営業外費用合計	46, 052	93, 432
経常損失(△)	△156, 326	△578, 520
特別利益		
負ののれん発生益	_	1, 172, 384
特別利益合計	_	1, 172, 384
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	△156, 326	593, 863
法人税、住民税及び事業税	12, 035	14, 822
法人税等調整額	△48, 642	△10, 608
法人税等合計	△36, 607	4, 214
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△119, 719	589, 649
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主 に帰属する四半期純損失 (△)	△119, 719	589, 649

四半期連結包括利益計算書 第3四半期連結累計期間

		(単位:千円)_
	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△119, 719	589, 649
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	56, 967	△25 , 663
退職給付に係る調整額	△10 , 441	△3, 782
その他の包括利益合計	46, 525	△29, 445
四半期包括利益	△73, 194	560, 203
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△73, 194	560, 203

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動) 該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					四半期連結
	I J P ソリ ューション 事業	半導体 関連事業	LCD 事業	合計	調整額 (注) 1	損益計算書計上額(注)2
売上高						
外部顧客への売上高	1, 224, 903	1, 645, 187	3, 911, 435	6, 781, 526	_	6, 781, 526
セグメント間の内部売上高 又は振替高	_	_	_	_	_	_
ii- -	1, 224, 903	1, 645, 187	3, 911, 435	6, 781, 526	_	6, 781, 526
セグメント利益又は損失(△)	49, 407	289, 208	347, 843	686, 460	△802, 418	△115, 958

- (注) 1. セグメント利益又は損失の調整額 \triangle 802, 418千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における売上原価・一般管理費 \triangle 802, 418千円であります。
 - 2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
- 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2023年3月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					四半期連結
	I J P ソリ ューション 事業	半導体 関連事業	LCD 事業	合計	調整額 (注) 1	損益計算書計上額(注)2
売上高						
外部顧客への売上高	2, 536, 483	3, 050, 076	2, 185, 155	7, 771, 716	_	7, 771, 716
セグメント間の内部売上高 又は振替高	_	_	_	_	_	_
11 A	2, 536, 483	3, 050, 076	2, 185, 155	7, 771, 716	_	7, 771, 716
セグメント利益又は損失(△)	35, 850	416, 058	△121, 899	330, 009	△819, 751	△489, 742

- (注) 1. セグメント利益又は損失の調整額 \triangle 819,751千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における売上原価・一般管理費 \triangle 819,751千円であります。
 - 2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
- 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

半導体関連事業において、当第3四半期連結累計期間より東京応化工業株式会社が設立したプロセス機器事業分割準備株式会社の取得に伴い、負ののれんが発生しております。当該事象による負ののれん発生益の計上額は1,172,384千円であります。

なお、当該負ののれん発生益の金額は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。また、負ののれん発生益は特別利益のため、上記セグメント利益には含まれておりません。

(企業結合等関係)

(取得による企業結合)

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 : プロセス機器事業分割準備株式会社

事業の内容 : 半導体及びディスプレイ用の製造装置等の各種プロセス機器の製造及び販売

(2) 企業結合を行った主な理由

当社グループが開発・製造するはんだボールマウンタ等の半導体製造装置業界においては、競争激化等を背景に技術革新のスピードの加速や高度な専門性が求められています。

このような状況の下、事業の選択と集中を模索していた東京応化工業株式会社との間で同社のプロセス機器 事業本部が営む半導体用・ディスプレイ用装置製造事業の譲受につき検討することとなり、今般両社で合意に 至ったためです。

(3) 企業結合日 : 2023年3月1日

(4) 企業結合の法的形式:現金を対価とする株式取得

(5) 取得した議決権比率:100%

(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠 当社が現金を対価として株式を取得するものです。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2023年3月1日から2023年3月31日まで

なお、当社を存続会社、被取得企業を消滅会社とする吸収合併の効力発生日である2023年3月1日以降、2023年3月31日までの期間を含みます。

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価(注) 現金 682,178千円

取得原価

682,178千円

- (注) 既に支払済の対価に加え、被取得企業の一定期間の業績達成度合いに応じて条件付取得対価を追加で支払う場合があります。
- 4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 54,138千円

- 5. 負ののれん発生益の金額、発生原因
- (1) 発生した負ののれんの金額

1,172,384千円

なお、負ののれん発生益の金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定した金額であります。

(2) 発生原因

企業結合時における時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として処理しています。

(共通支配下の取引等)

1. 取引の概要

(1) 合併企業の名称及び事業の内容

企業の名称 プロセス機器事業分割準備株式会社

事業の内容 半導体及びディスプレイ用の製造装置等の各種プロセス機器の製造及び販売

(2) 企業結合日 2023年3月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社、プロセス機器事業分割準備株式会社を消滅会社とする吸収合併

(4) 合併後の企業の名称 変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

当社グループが開発・製造するはんだボールマウンタ等の半導体製造装置業界においては、競争激化等を背景に技術革新のスピードの加速や高度な専門性が求められています。

当社とプロセス機器事業分割準備株式会社は、共に半導体用製造装置等の製造・販売を手掛けていることから、当社グループ全体でより効率的かつ効果的な事業展開を図るため、合併を行うこととしました。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。